合庫投信 2026

2026Q1 議合紀錄

壹、議合評估與流程

一、互動議合前

參與議合人員至少須對被投資公司有初步了解。為確實有效掌握資訊，相關人員可參考本公司與其他專業機構之期刊及報告，及被投資公司財務報表與營運計畫，或參加研討會及拜訪專業人士等蒐集研究相關資訊之活動。

二、互動議合之時機

1. 被投資公司舉辦公開法人說明會或座談時。
2. 據第三者的評估報告、新聞訊息或產業趨勢、法規發生變化，鑑別出被投資公司有潛在 ESG 或投資的機會或風險時。
4. 被投資公告股東會議事手冊後，本公司對提案內容有疑義時。

三、互動議合之主題

1. 被投資公司經營現況以及未來發展之機會與風險。
2. 這些機會與風險是否與 ESG 議題相關。
3. 被投資公司針對這些機會與風險提出對應的經營策略。

四、互動議合之方式

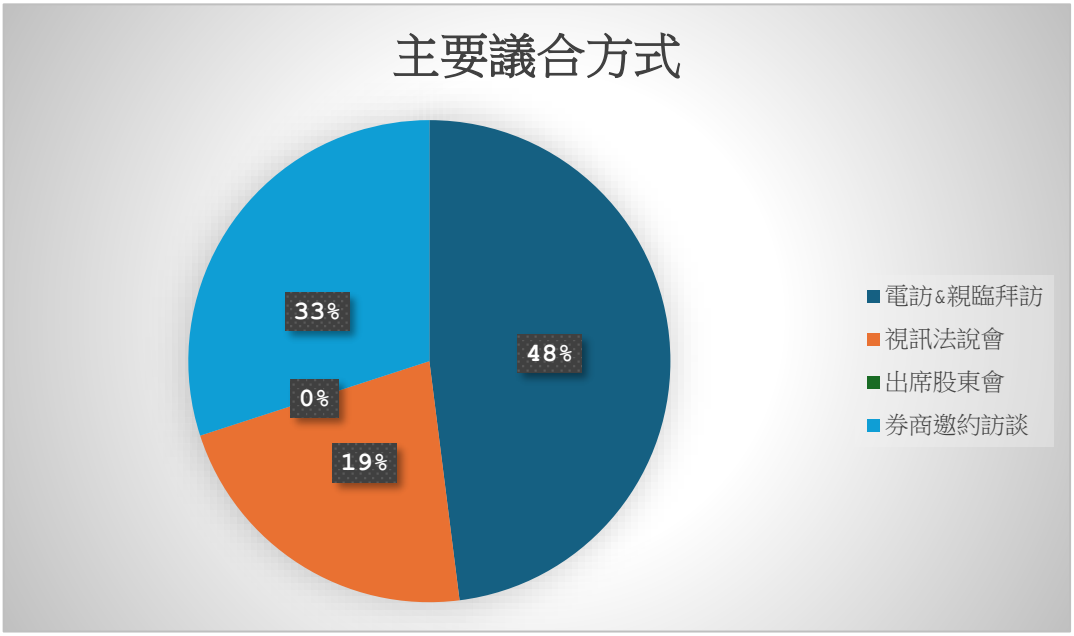
1. 本公司可單獨或與其他投資機構一起與被投資公司議合。
2. 本公司可透過電話、視訊、或實體會議與被投資公司議合。
3. 本公司可透過書面或口頭與被投資公司的經營階層溝通。
4. 本公司可藉由股東會發表意見、提出股東會議案，及參與股東會投票，來表示意見。

五、互動議合後

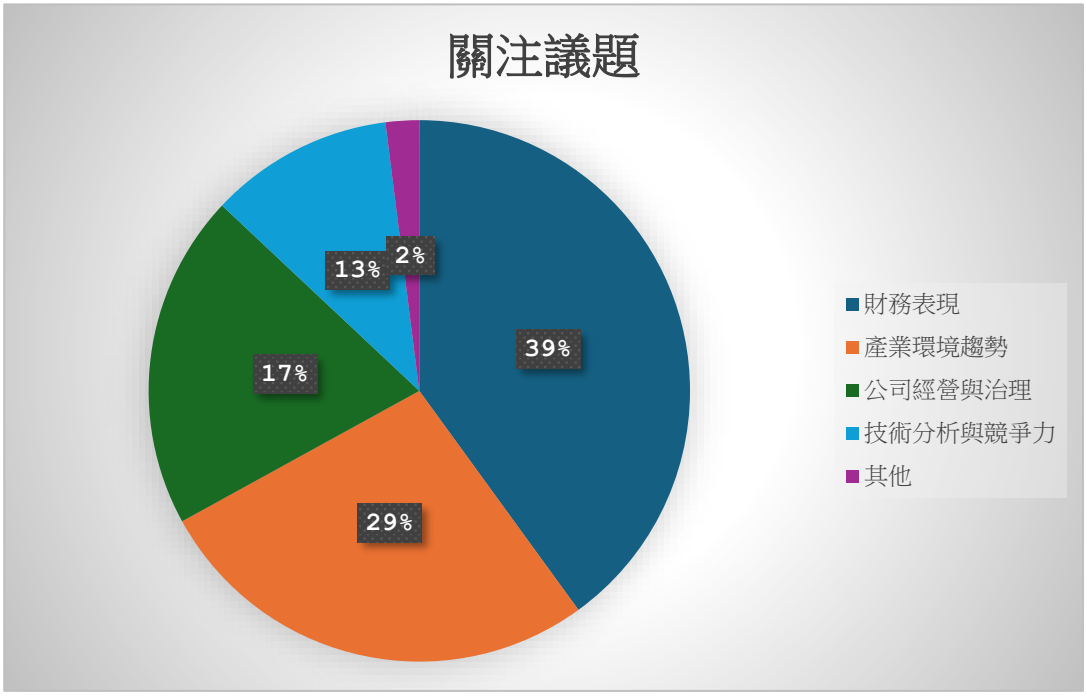
1. 經理人及研究員拜訪發行公司應記錄相關人員、時間、地點、訪談內容資料等。
2. 如與有違反 ESG 議題之被投資公司議合後，應追蹤其改善情形，並進一步評估之後的投資決策。如受裁罰且未改善者，應退出該公司之投資。

貳、議合執行情形與揭露

一、 本公司 115 年度 Q1 定期議和活動呈現方式透過電訪、或親自拜訪，視訊法說會，出席股東會，證券商提供約訪及場地與被投資公司會議。



二、 115 年度 Q1 關注議題概分為財務表現、產業環境趨勢、經營策略與公司治理、技術分析與競爭力及其他。



一、盡職治理著重與被投資公司互動與議合，機構投資人應監督被投資公司之公司治理，針對我們投資組合中持股的被投資公司，我們會在資料庫中記錄我們的議合活動。記錄的內容包含但不限於背景說明、盡職治理 評估、影響與後續追蹤。為確保議合的執行符合盡職治理政策，我們會設定目標的預期達成時間，並依此追蹤進度，必要時會修訂這些時間表。注重互動、議合後所帶給被投資公司正面的影響，包括公司未來發展策略、產品策略、生產策略、自動化的進程和勞工權益、股利發放的比例、綠能和節能上的未來計劃等，進而決定後續的投資決策。以下為本公司揭露與被投資公司的議合活動時的內容案例。

合庫投信 CALL MEMO

公司名稱：2379 瑞昱　　拜訪日期：2026.01.28　　拜訪形式：法說會

股本：51.29 億　　股價：525 元　　每股淨值(3Q25)：92.5 元

背景資料：瑞昱以通訊晶片為主軸，包含 WLAN、Ethernet、ADSL 等，主要競爭對手為 Broadcom、BK、聯發科、聯詠等；主要客戶為 HP、DELL、ASUS、Acer、TP Link、合勤、創惟、海信、TCL、康佳等。

投資建議：中立，消費性產品需求恐因記憶體漲價推升終端售價而出現下滑，加上客戶希望瑞昱幫忙分攤成本。至於市場期待的 AI 業務仍有待觀察後續發展，預估具現金殖利率 4.6%。

營運概況:

年度	EPS(元)	配息	備註
2023	17.85	15.5/87%	
2024	29.82	25.5/85.4%	
2025	28.77	24.5/85.2%(F)	
2026(F)	29.15		

＊拜訪概述

1. 1Q25：營收 350.22 億元，年增 36.68%、季增 32.9%，毛利率 51.6%，營益率 14%，業外 7.02 億元，稅前盈餘 56.05 億元，稅後盈餘 47.62 億元，EPS 9.28 元。
2. 2Q25：營收 319.14 億元，年增 4.04%，毛利率 50.23%，營益率 12.56%，業外 6.16 億元，稅前盈餘 46.24 億元，稅後盈餘 39.09 億元，EPS 7.62 元。
3. 3Q25：營收 294.91 億元，年減 4.1%，毛利率 49.68%，營益率 10.6%，業外 9.32 億元，稅前盈餘 40.45 億元，稅後盈餘 34.29 億元，EPS 6.69 元。
4. 4Q25：營收 262.78 億元，年減 0.25%，毛利率 48.1%（調整庫存），營益率 8.9%，業外 6.51 億元，稅前盈餘億元，稅後盈餘 26.54 億元，EPS 5.17 元。
5. 2025：營收 1227.06 億元，年增 8.21%，毛利率 50%，營益率 11.7%，業外 29.01 億元，稅前盈餘億元，稅後盈餘 147.53 億元，EPS 28.77 元。2025 年營運逐季向下。
6. 1Q26 展望：**對短期運營保持謹慎樂觀，因為客戶將補庫存和預先備貨。但為應對供應鏈的不確定性，將繼續密切監控外部環境和各市場的發展。為了應對供應鏈的不確定性，公司看到客戶將訂單提前，從第二季度提前到第一季度。**

7. 2026 年展望：**瑞昱預期終端“電視、遊戲和家電”會增長**。2026 年 FIFA 世界盃預計將促進大螢幕 OLED 和 mini-LED TV 的更換。遊戲主機市場預計將擴大，因下一代設備如任天堂 Switch 2 和熱門遊戲如 GTA 6 的推動，可能增加硬體需求。OEM 和 ODM 對 embedded DRAM 和 Flash 的偏好有增加的趨勢，然而 embedded 記憶體零組件會對公司毛利率有壓力，因為 OEM 和 ODM 期望直接轉嫁，瑞昱會優化成本跟性能確保產品有競爭力並努力維持毛利率。**2026 年增長最大的應該是網路**。
8. 區域：2026 年中國國內市場的增長預計將微乎其微，甚至可能下降。南美和南亞則因有利政策而增長。
9. 原物料漲價：**客戶希望瑞昱可以吸收上游的成本**，公司積極跟客戶還有供應商合作，期望可以找到可行的解決方案。成本上升可能對需求造成壓力，但觀察目前的主要客戶還沒有出現急劇的銷量下降。
10. 存貨：4Q 195.61 億元(3Q 168.71 億元)。庫存週轉天數 127 天(3Q 105 天)。目前庫存是健康的，現在的庫存比較高是因為 4Q 季節性疲軟和公司主動累積庫存(供貨給年後訂單)。預計 1Q26 庫存會增加，不過仍然會是健康的。
11. PC / NON PC：4Q25 32/67%。3Q 35/65。瑞昱 4Q PC 相關出貨量減少
12. PC：4Q 全球 PC 出貨量達 7640 萬台(3Q 7550 萬台)，由於企業升級至 Windows 11 以及面對 2026 年潛在供應風險的策略性提前準備。IDC 預估 2026 年產業因全球記憶體短缺面臨重大波動，主因為強勁的 AI 伺服器需求。預計記憶體的短缺將推高零組件價格，導致 PC 零售價格上漲。**2026 年全年 PC 單位出貨量預計將下降約 2.4%。**瑞昱在 PC 業務的增長主要來自價值增長，透過將 AI 加速器，像是 AI camera 還有 AI 指紋辨識等，嵌入外圍設備來增加價值。
13. 網路：受到 2025 年底 AI 自動化推動，網路基礎設施市場經歷重大轉折。這一現象在 PON 市場中最明顯，其中超過 10Gbps 成為 5G 和 Wi-Fi 7 首選解決方案。Wi-Fi 7 的滲透率正在上升，瑞昱在高速的解決方案跟交換機中保持領先地位。瑞昱是市場上乙太網解決方案的領先提供商，支持包括 2.5G、5G 和 10G。公司的 10G 以太網產品現在越來越多地出現在伺服器級 PC、交換機、Wi-Fi 7 路由器和 PON 應用中。
14. 乙太網：中國企業受到政府的大力扶持，中國公司持續在他們的國內市場獲得市場份額。
15. Wi-Fi：Wi-Fi 8 技術的產品將於 2028 年上市。預計 Wi-Fi 7 產品滲透率會在今年翻倍。Wi-Fi 5、6 和 7 之間的平均售價比率約為 1:1.6:3.3。。
16. 汽車市場：瑞昱的汽車以太網業務成長超過整體公司的增長。根據 S&P Mobility 的預測 2026 年每輛車中的電子產品價值持續上升，瑞昱在這些趨勢中處於有利位置，汽車產品會擴展到包括 Wi-Fi、藍牙、audio DSP、智能座艙和 display retimer 解決方案。2026 年全球輕型車輛的生產預計將保持平穩或略微下降，受到關稅通脹和北美及歐洲電動車需求減弱的影

響。儘管二手車市場的需求正在回升，並且全球對混合動力車的興趣重新燃起，但整體新車銷售預計將保持平穩。

17. ASIC 業務：瑞昱致力於開發更快、更靈活且更易於管理的連接解決方案。公司有一系列 AI 驅動的電視和智能顯示器、智能家居的 AI 生態系統等。未來公司將推出一款針對工業和商業應用設計的邊緣優化 AI 處理器，以及針對數據和 AI 伺服器的超高速連接解決方案。
18. 光模組：瑞昱目前專注於開發在 112 Gbps 和 224 Gbps 下運行的 10G SerDes，利用先進的 12 奈米晶圓。公司預計本季度將推出 100G 光模組的控制 IC。400G PAM4 DSP 跟 800G PAM4 DSP 的 Tape out 進展順利。
19. 晶圓代工：晶圓廠和封裝廠將大量的資源重新分配到更先進的技術上時，可能導致整個供應鏈的價格壓力增加。公司與供應商之間建立長期的夥伴關係，公司對 2026 年的成本有信心。。

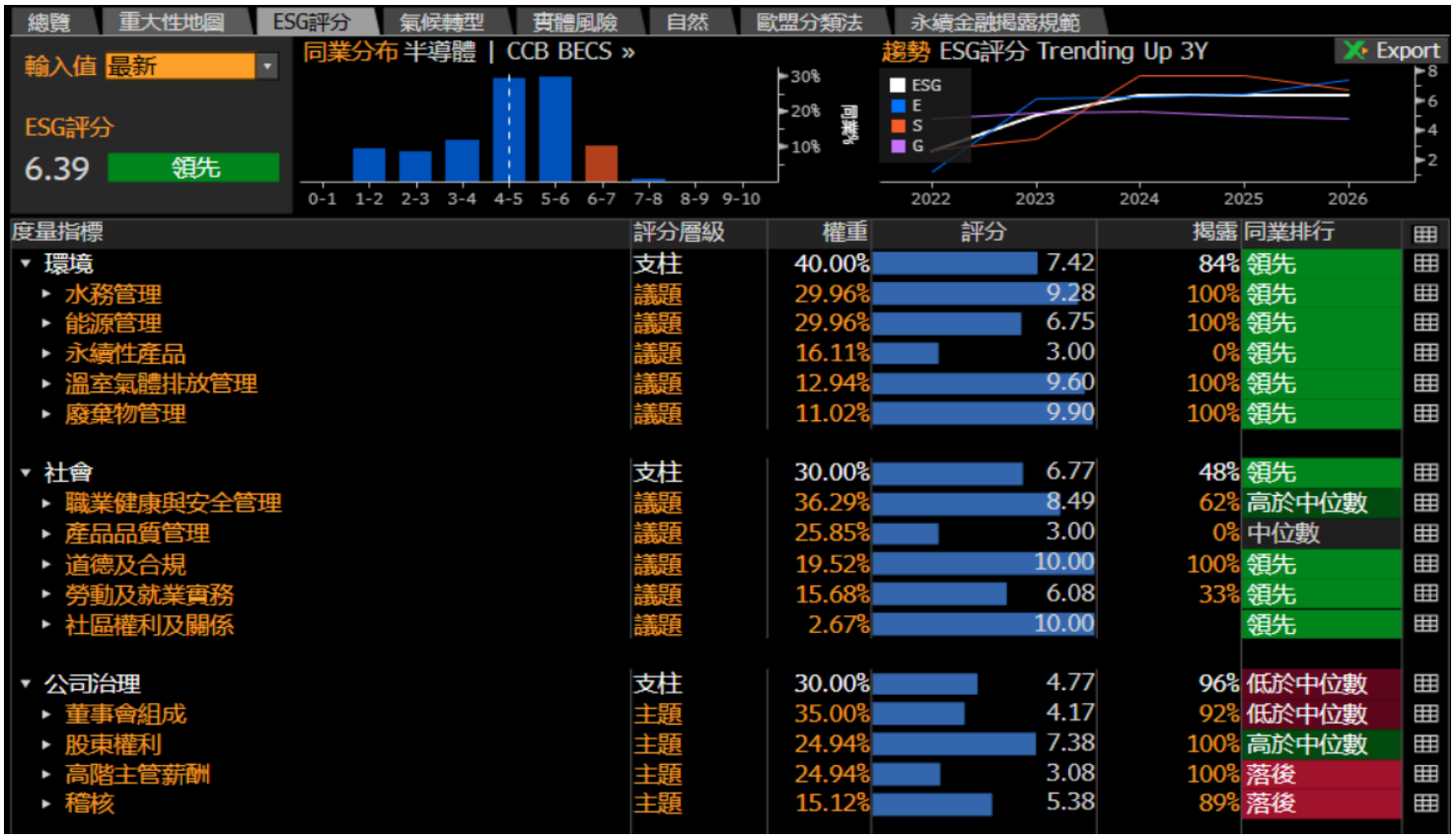
＊合理評價

2026 PER 18X，近 4 年 PER 7~31X，由於營運動能不強但是仍具現金殖利率，評價應可獲得支撐。



ESG 分析


總覽 重大性地圖 ESG評分 氣候轉型 實體風險 自然 歐盟分類法 永續金融揭露規範
金融重大性評分 | ESG SCORE »
分數 趨勢 與同業比較
ESG評分 6.39 +0.42 領先
環境 7.42 +0.50 領先
社會 6.77 +1.38 領先
公司治理 4.77 -0.57 低於中位數
第三方評分 | RV ESG »
MSCI評等 A
Sustainalytics風險評分 16.67
標普全球ESG排行 93.00
RepRisk評等 --
重大性主題 | ESG MM »
能源管理 領先
水務管理 領先
職業健康與安全管理 高於中位數
氣候實體風險 | ESG CLMR »
資產損壞率 4.4%
高風險資產% --
主要風險因子 --
歐盟SFDR | ESG SFDR »
聯合國全球盟約違規 N
董事會女性% 11.1%
化石燃料風險暴露% 0.0%
公司治理 | ESGD GOVN »
獨立董事% 33.3%
執行長薪酬 --
平均董事任期 12.6Yr
機構所持自由股 60.5%
薪酬發言權支持率 --
股東提案 (件數) 0
氣候轉型 | ESG NETZ »
轉型評估 追隨者
碳目標 Y
轉型計劃 Y
轉型營收% 0.0%
轉型資本支出% --
總溫室氣體/銷售 10
永續性債務 | SRCH »
綠色債務 --
社會債務 --
永續性 --
永續性連結 --
過渡 --
永續性債務曲線 »
總計 --
營收細項 | CCB »
半導體元件 100.0%
自然 | ESG NATURE »
高風險行業營收% 100.0%
董事會生物多樣性監督 --
資產自然風險 Y
ESG基金風險暴露 | FSRC »
ESG基金 1221
第9條基金 14
第8條基金 971


總覽 重大性地圖 ESG評分 氣候轉型 實體風險 自然 歐盟分類法 永續金融揭露規範
輸入值 最新
ESG評分
6.39 領先
同業分布 半導體 | CCB BECS »
趨勢 ESG評分 Trending Up 3Y
Export
ESG
E
S
G
度量指標 評分層級 權重 評分 揭露 同業排行
環境 支柱 40.00% 7.42 84% 領先
水務管理 議題 29.96% 9.28 100% 領先
能源管理 議題 29.96% 6.75 100% 領先
永續性產品 議題 16.11% 3.00 0% 領先
溫室氣體排放管理 議題 12.94% 9.60 100% 領先
廢棄物管理 議題 11.02% 9.90 100% 領先
社會 支柱 30.00% 6.77 48% 領先
職業健康與安全管理 議題 36.29% 8.49 62% 高於中位數
產品品質管理 議題 25.85% 3.00 0% 中位數
道德及合規 議題 19.52% 10.00 100% 領先
勞動及就業實務 議題 15.68% 6.08 33% 領先
社區權利及關係 議題 2.67% 10.00 領先
公司治理 支柱 30.00% 4.77 96% 低於中位數
董事會組成 主題 35.00% 4.17 92% 低於中位數
股東權利 主題 24.94% 7.38 100% 高於中位數
高階主管薪酬 主題 24.94% 3.08 100% 落後
稽核 主題 15.12% 5.38 89% 落後

Q1：貴公司落實環境永續之管理制度與外部查證情形如何？

Ans：本公司為國內 IC 設計業導入管理系統之先行者，1995 年即取得 ISO 9001 認證，2006 年取得 ISO 14001 環境管理系統認證，以系統化方式管理各營運據點之環境績效。溫室氣體管理方面，本公司自 2019 年起即先於主管機關法規要求主動展開盤查，並持續取得 ISO 14064-1 溫室氣體排放量查證聲明書，逐年擴大盤查邊界，2024 年已涵蓋財報邊界內國內外共 16 個據點，以第三方查證確保揭露數據之完整性與可信度。

Q2：貴公司之淨零排放目標及具體推動方向為何？

Ans：本公司已承諾於 2050 年達成淨零碳排，並自五大方向逐步推進：持續開發低碳產品、改善設備能源效率、依循綠建築標準興建辦公大樓並取得認證、提高再生能源使用比例，以及落實供應鏈減碳目標管理。目前並正著手申請 SBTi 科學基礎減量目標，以使中長期減量路徑符合國際科學方法。

Q3：貴公司如何回應客戶與外部利害關係人之環境資訊需求？

Ans：本公司每年編製永續報告書、於證交所 ESG 數位平台申報永續資訊，並填答 CDP 問卷，同時配合國際供應鏈客戶提供所需之碳排與環境資訊。為提升數據品質與作業效率，本公司已導入碳管理資訊系統，實現活動數據自動彙整與跨據點一致管理，並依 ISO 14064-1 與 GHG Protocol 分類產出報表，以因應包括 IFRS S2 氣候相關揭露在內之未來揭露要求。

合庫投信 CALL MEMO

公司名稱：6239 力成　　拜訪日期：2026.01.27　　拜訪形式：法說會
股本：75.91 億　　股價：263.5 元　　每股淨值(4Q25)：74.15 元

背景資料:以發展記憶體積體電路之封測業務為策略,原以記憶體測試業務起家,2000 年購入力晶後段設備後開始提供客戶封裝加測試一貫化服務，2012 年入股超豐電子後成為其大股東（持股 43%)，並提供邏輯 IC 封裝業務，主要客戶為鎧俠、Intel、美光、金士頓、南亞科等。

投資建議：中立，FOPLP 明顯貢獻營運約在 2027 年。

營運概況:

年度	EPS(元)	配息/配息率	備註
2023	10.72	7/65.3%	
2024	9.09	7/77%	
2025	7.48	/60~70%	超豐配息 65~70%
2026(F)	10.28		群益(F)

＊拜訪概述

1. 1Q25：營收 154.94 億元，年減 15.5%，毛利率 17.1%，營益率 10%，業外 2.56 億元(匯兌 0.8 億元)，稅前盈餘 15.78 億元，稅後盈餘 11.75 億元，稅後 eps 1.58 元。
2. 2Q25：營收 180.6 億元，年減 7.8%、季增 16.6%，毛利率 15.9%，營益率 10.2%，業外虧損 2.68 億元(匯損 6.7 億元)，稅前盈餘 12.75 億元，稅後盈餘 9.6 億元，稅後 eps 1.3 元。台幣升值 1%影響毛利率 0.6%。封/測稼動率 80/70%
3. 3Q25：營收 199.68 億元，年增 9.1%、季增 10.56%，毛利率 16.1%，營益率 10.3%，業外 2.6 億元(匯兌 2.4 億元)，稅前盈餘 23.7 億元，稅後盈餘 15.38 億元，稅後 eps 2.08 元。。封/測稼動率 80/70%
4. 4Q25：營收 214.07 億元，季增 7.2%，年增 25.21%，毛利率 18.6%，營益率 12.6%，業外 3.54 億元**(匯兌億元)**，稅前盈餘 30.5 億元，稅後盈餘 23.32 億元，稅後 eps 2.52 元。封/測稼動率 90/85%
5. 2025：營收 749.29 億元，年增 2.2%(1H24 有西安廠貢獻 35 億元)，毛利率 17%，營益率 10.9%，業外 6.6 億元，稅前盈餘 87.92 億元，稅後盈餘 72.21 億元，**稅後 eps 7.48 元**。
6. 1Q26 展望 ： **受惠記憶體循環週期及 AI 需求暢旺，整體產能趨緊營收持續上揚**。持續精進 AI 相關先進封測技術認證通過後出貨續增將為新成長動

能。**營收因為工作天數影響將出現季減**。目前稼動率在 3Q25~4Q25 之間。**隨著客戶報價持續上升，力成也因成本提升已從 4Q25 宣告調高價格，預期 1Q26 生效**，有助於毛利率回升。但是金架是另外計算，跟客戶用月報價或季均價報價，但是可以跟客戶反應，只是跟不上金價的漲幅。

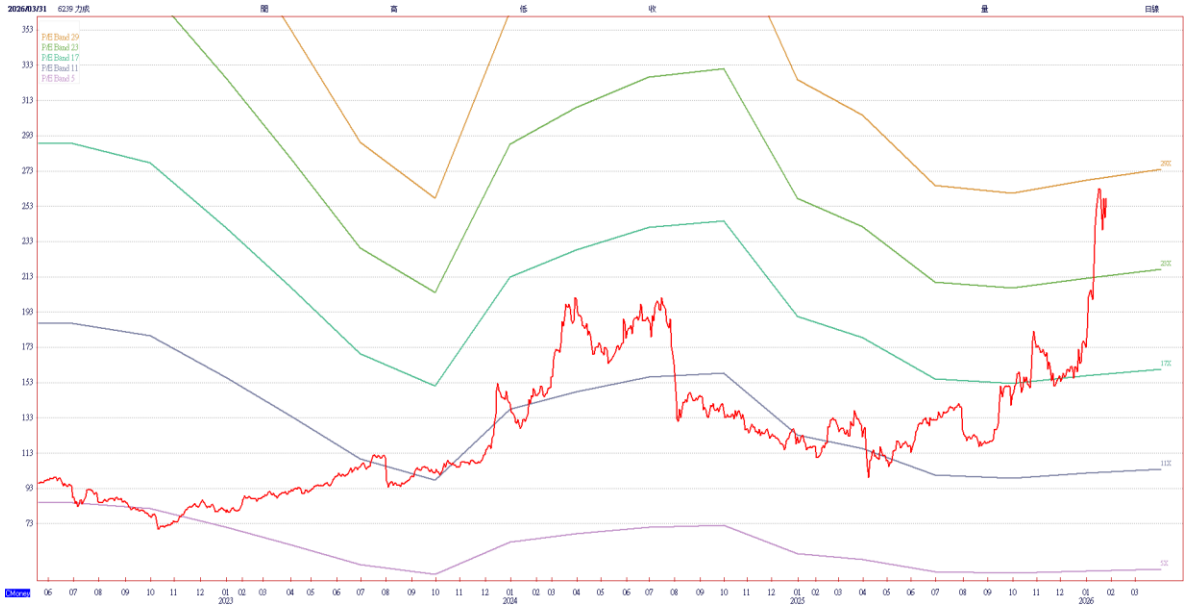
7. 2026 展望：記憶體 1Q 淡季不淡，維持高位數年增。2Q 動能持續，年高雙位數成長。邏輯看好 Flip Chip 與 BGA 的成長。Advanced package 處在產能擴充階段，今年擴充 3K，明年再增加 3K 產能。
8. 載板：BT、ABF 載板供給吃緊，目前看 2026 年還是缺。力成採購仍可滿足，只是價格有調漲。
9. 產品組合-服務別：4Q/3Q 封裝 65/67%，測試 22/22%，SIP/Module 13/11%。
10. 產品組合-依產品別：4Q/3Q Logic 39/40%、SiP/Module 13/11%、**NAND Flash 27**/25%、DRAM 21/24%。Logic 包含超豐、力成與 Tera Probe/Tera Power。
11. 終端應用：4Q/3Q computing 24/23%、Communication 28/26%、Consumer 23/26%、Auto 13/14%、AI 10/8%、Industry 2/3%。AI 客戶是 AWS，Google。
12. DRAM：4Q 受惠需求強勁，營收季增高個位數、年增雙位數。Mobile 市場需求略為向下、營收季略減、年增雙位數。車用記憶體客戶出貨需求正面，營收季持平、年增雙位數。**1Q26 資料中心展望持續上修，對 DRAM 需求高於預期，惟須注意資料中心與其它應用之產能配置**。AI 需求帶動儲存多樣化，擴大導入 LPDRAM 及 GDDR7 於 server 架構中，有助於訂單需求。車用市場庫存處於低檔，若需求出現或供應鏈出現擾動，將有機會啟動庫存回補循環。**1H26 持續看好**。
13. NAND/SSD：1H25 需求疲弱。4Q 隨著 AI server 等 eSSD 需求上揚營收續增。eSSD 需求及出貨暢旺，營收季、年增雙位數。**1Q26 NAND 封測訂單在資料中心與 eSSD 需求持續成長帶動下，動能不減，淡季不淡；2Q 動能進一步加溫，1H26 看法正向**。
14. Logic：4Q 出貨續增，營收季增高個位數、年增雙位數。超豐受客戶需求推動營收年增高個位數成長。Tera Probe / Tera power 因應客戶需求，續投 CAPEX，營收季、年增雙位數。1Q26 Logic 封測業務受惠高階封裝 FC_BGA 需求持續成長，加上整體產能利用率維持高檔水位，在產品組合優化下，預期對邏輯封裝業務的毛利將有顯著的貢獻。
15. Tera Probe(日本公司、持股 60%)/Tera Power（合計持股 80%)：持續購入廠房增加產能。1Q26 營收維持穩定成長，得益於 ADAS、伺服器及機器學習/人工智慧應用領域的的強勁需求。消費性 DRAM 和消費性邏輯產品相關需求呈現溫和增加，2025 年產品售價有調漲幾次，也將持續調漲價格。車用產品中日本仍維持持平，TPW 車用輔助系統(ADAS)顯著成長。今天在湖口

工業區**順利購得廠房，未來將可以擴增產能。可以增加 400~500 台產能**。

16. 超豐：稼動率較 2024 年增加 10 個百分點。稅後 24.49 億元，稅後 eps 3.41 元。Flip chip 佔封測 7%約 7000 多萬，做多可以做到 1.2 億元。預期 2Q 客戶認證過後可滿載。2026 下半年持續擴充產能，若滿載營收約 2.8 億元
17. 資本支出：2025 年 195 億元。未來三年將投資 300~400 億元於 Fanout。
18. FOPLP：研發與認證的產品分別是 AI Chips（CPU 與 ASIC 為主）、Optical Engine、AI chips integrated with CPO（@2027 年）。510mm*515mm，已順利取得設備與材料供應商的支持。一個月 6000 片，2.1 萬片 wafer form。但是設備被同業搶走，今年、明年分兩次到位。設備最缺是在 on ABF substrate。先進封測持續深化客戶端合作及加速樣品驗證外，同步與主要材料及設備供應商展開合作以確保整體供應鏈能穩定運作，預期 2027 交付量產。在客戶訂單能見度提升下新購入之 P12 廠區(購自友達)將同步擴建新產能以確保產能供給與交付彈性支持未來 2028~2029 營運的成長動能。力成本身有 bumping 的廠，未來將優先供應自用，所以會淘汰其他低毛利率應用的產品。未來產品還要做 CP、FT 測試，也將會交給 Tera Power 做。
19. Warpage：半導體中的晶圓翹曲(Wafer Warpage)是指晶圓或晶片在製程中因不同材料熱膨脹係數(CTE) 差異，導致彎曲變形，這在先進封裝 Fan-out 中非常普遍，會造成移載困難、對位不良，嚴重影響良率；解決方案包括使用載體、特殊材料、低溫製程、以及開發翹曲抑制/平整系統。**但是已經不是力成的問題**
20. 美光買力積電影響：公司認為沒有影響

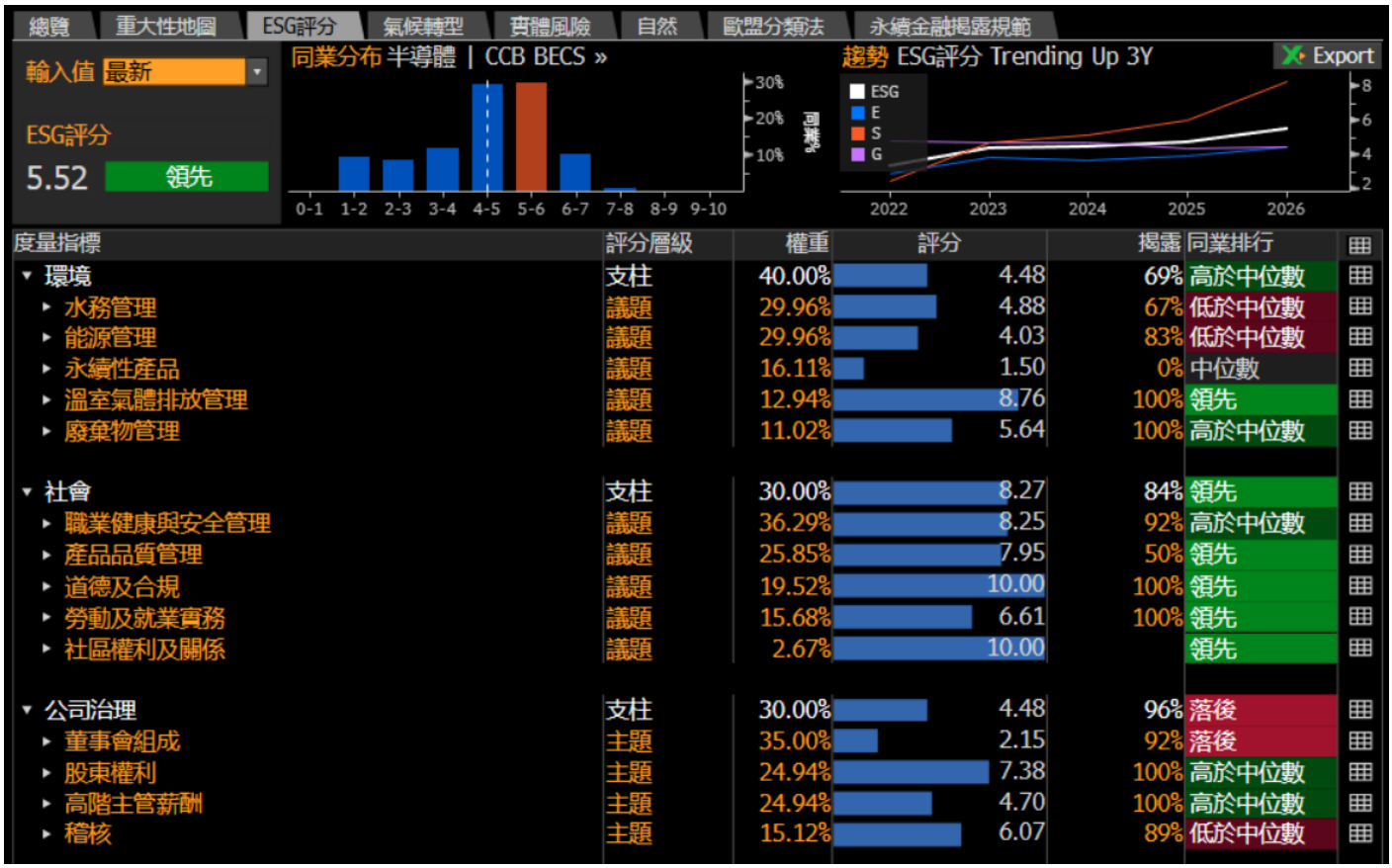
＊合理評價

2026 年 X PER，近四年 PER 5~29X，FOPLP 是明年～後年市場關注焦點，但評價並未特別便宜。



ESG 分析


總覽 重大性地圖 ESG評分 氣候轉型 實體風險 自然 歐盟分類法 永續金融揭露規範
金融重大性評分 | ESG SCORE »
分數 趨勢 與同業比較
ESG評分 5.52 +0.60 領先
環境 4.48 +0.45 高於中位數
社會 8.27 +1.69 領先
公司治理 4.48 -0.12 落後
第三方評分 | RV ESG »
MSCI評等 --
Sustainalytics風險評分 16.79
標普全球ESG排行 91.00
RepRisk評等 A
重大性主題 | ESG MM »
能源管理 低於中位數
水務管理 低於中位數
職業健康與安全管理 高於中位數
氣候實體風險 | ESG CLMR »
資產損壞率 7.1%
高風險資產% --
主要風險因子 --
歐盟SFDR | ESG SFDR »
聯合國全球盟約違規 Y
董事會女性% 11.1%
化石燃料風險暴露% 0.0%
公司治理 | ESGD GOVN »
獨立董事% 40.0%
執行長薪酬 --
平均董事任期 9.1Yr
機構所持自由股 37.2%
Lowest Management Support 64.1%
股東提案 (件數) 0
氣候轉型 | ESG NETZ »
轉型評估 追隨者
碳目標 Y
轉型計劃 Y
轉型營收% 0.0%
轉型資本支出% --
溫室氣體/銷售 256
永續性債務 | SRCH »
綠色債務 --
社會債務 --
永續性 --
永續性連結 --
過渡 --
永續性債務曲線 »
總計 --
營收細項 | CCB »
半導體製造 100.0%
自然 | ESG NATURE »
高風險行業營收% 100.0%
董事會生物多樣性監督 --
資產自然風險 Y
ESG基金風險暴露 | FSRC »
ESG基金 394
第9條基金 4
第8條基金 --


總覽 重大性地圖 ESG評分 氣候轉型 實體風險 自然 歐盟分類法 永續金融揭露規範
輸入值 最新
ESG評分
5.52 領先
同業分布 半導體 | CCB BECS »
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
趨勢 ESG評分 Trending Up 3Y
Export
ESG
E
S
G
2022 2023 2024 2025 2026
度量指標 評分層級 權重 評分 揭露 同業排行
環境 支柱 40.00% 4.48 69% 高於中位數
水務管理 議題 29.96% 4.88 67% 低於中位數
能源管理 議題 29.96% 4.03 83% 低於中位數
永續性產品 議題 16.11% 1.50 0% 中位數
溫室氣體排放管理 議題 12.94% 8.76 100% 領先
廢棄物管理 議題 11.02% 5.64 100% 高於中位數
社會 支柱 30.00% 8.27 84% 領先
職業健康與安全管理 議題 36.29% 8.25 92% 高於中位數
產品品質管理 議題 25.85% 7.95 50% 領先
道德及合規 議題 19.52% 10.00 100% 領先
勞動及就業實務 議題 15.68% 6.61 100% 領先
社區權利及關係 議題 2.67% 10.00 領先
公司治理 支柱 30.00% 4.48 96% 落後
董事會組成 主題 35.00% 2.15 92% 落後
股東權利 主題 24.94% 7.38 100% 高於中位數
高階主管薪酬 主題 24.94% 4.70 100% 高於中位數
稽核 主題 15.12% 6.07 89% 低於中位數

Q1：貴公司如何在生產與環境成本間取得平衡？

Ans： 本公司設置「永續發展管理室」為隸屬董事會之專職單位，負責永續政策與具體推動專案，並每年向董事會報告執行成效，將環境管理納入經營決策層級。能源管理方面，已有 8 個廠區通過 ISO 50001 能源管理系統驗證，並於新廠設立時導入綠建築設計，選配溫室效應潛勢低之環保冷媒與 IE3 等級以上高效率馬達，同時持續汰換老舊機組。2024 年全公司節電達 14,182,415 度，約減少 7,006.11 公噸 CO2e 排放，達成 1%節電量目標，兼顧產能成長與環境績效。

Q2：貴公司溫室氣體盤查結果與再生能源推動規劃為何？

Ans： 本公司參照 ISO 14064-1:2018 等國內外盤查指引建立溫室氣體盤查管理流程，並依 TCFD 架構進行氣候變遷風險與機會分析。2024 年類別 1 直接排放為 7,455.97 公噸 CO2e、類別 2 能源間接排放為 339,416.97 公噸 CO2e，合計 346,872.94 公噸 CO2e，其中類別 2 占約 97.85%，顯示外購電力為主要排放來源，故以提高再生能源占比為核心減量路徑。再生能源規劃分三階段推動：第一階段於 2023 年達成《再生能源發展條例》用電大戶要求，使用量 8,535,594 度／年；第二階段以太陽光電及風電逐步提高占比，2025 年達 5%、2030 年達 15%；第三階段於 2050 年達成政府淨零及客戶 RE100 供應鏈要求。2024 年並購買 20,894 張再生能源憑證。

Q3：貴公司如何管理水資源風險與提升用水效率？

Ans：本公司用水 98.8%來自自來水、1.2%來自地下水，並輔以雨水回收供清潔與植栽澆灌，2024 年取用水量為 3,017.526 百萬公升，較 2023 年增加係因產能提升所致。針對具切割與研磨製程需求之廠區，已於湖口廠、大同廠、竹科一廠及竹科三廠建置廢水回收系統，並持續擴充容量；2018 至 2024 年回收率均維持於 85%目標以上，2024 年切割研磨製程回收率達 86.89%。另已制定供水緊急應變計劃，透過模擬與情境演練，並規劃啟用廠區儲水槽、水車載水及水井供水等應變措施，以降低缺水對營運之衝擊。